证券代码：002916　　证券简称：深南电路　　公告编号：2025-005

深南电路股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

☑是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深南电路	股票代码	002916
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丽君	谢丹	
办公地址	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	
传真	0755-86096378	0755-86096378	
电话	0755-86095188	0755-86095188	
电子信箱	stock@scc.com.cn	stock@scc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司所处的行业情况

深南电路成立于 1984 年，始终专注于电子互联领域，经过四十余年的深耕与发展，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项主营业务。公司已成为中国电子电路行业的领先企业，中国封装基板领域的先行者，电子装联特色企业，系国家火炬计划重点高新技术企业、电子电路行业首家国家技术创新示范企业和国家企业技术中心、中国电子电路行业协会（CPCA）理事长单位及标准委员会会长单位。

目前，公司已成为全球领先的无线基站射频功放 PCB 供应商、内资最大的封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商、电子装联制造的特色企业。根据 Prismark 报告，预计 2024 年公司营收规模在全球印制电路板厂商中位列第 4。

1）印制电路板（含封装基板）行业发展情况

根据 Prismark 2024 年第四季度报告统计，2024 年以美元计价的全球 PCB 产业产值同比增长 5.8%，其中 18 层及以上多层板、HDI 增速明显高于行业水平，主要得益于算力、高速网络通信和新能源汽车及 ADAS 等下游领域呈高景气，带动 PCB 产业相关产品需求保持较高增长；在宏观经济温和复苏、行业库存周期性回补的背景下，4-6 层板、8-16 层板、封装基板等产品的需求缓慢修复。中长期层面，PCB 产业延续高频高速、高精密度、高集成化等发展趋势，18 层及以上的高多层板、HDI 板、封装基板未来五年复合增速预计保持相对较高水平，分别为 15.7%、6.4%、7.4%。从区域分布看，未来五年全球各区域 PCB 产业仍呈增长态势，其中，中国大陆地区复合增长率为 4.3%。

2024-2029 年 PCB 产业发展情况预测（按产品类别）

单位：百万美元

类型/年份	2023	2024E		2029F	2024-2029F
	产值	产值	同比	产值	复合增长率
纸基板/单面/双面板	7,757	7,947	2.4%	9,149	2.9%
4-6 层板	15,434	15,736	2.0%	17,661	2.3%
8-16 层板	9,375	9,837	4.9%	12,192	4.4%
18 层板及以上	1,726	2,421	40.3%	5,020	15.7%
HDI	10,536	12,518	18.8%	17,037	6.4%
封装基板	12,498	12,602	0.8%	17,985	7.4%
柔性板	12,191	12,504	2.6%	15,617	4.5%
合计	**69,517**	**73,565**	**5.8%**	**94,661**	**5.2%**

数据来源：Prismark 2024 Q4 报告

2024-2029 年 PCB 产业发展情况预测（按地区）

单位：百万美元

类型/年份	2023	2024E		2029F	2024-2029F
	产值	产值	同比	产值	复合增长率
美洲	3,206	3,493	9.0%	4,075	3.1%
欧洲	1,728	1,638	-5.3%	1,863	2.6%
日本	6,078	5,840	-3.9%	7,855	6.1%
中国大陆	37,794	41,213	9.0%	50,804	4.3%
亚洲（日本、中国大陆除外）	20,710	21,382	3.2%	30,063	7.1%
合计	**69,517**	**73,565**	**5.8%**	**94,661**	**5.2%**

数据来源：Prismark 2024 Q4 报告

2）电子装联行业发展状况

电子装联处于 EMS 行业，狭义上指为各类电子产品提供制造服务的产业，代表制造环节的外包。目前全球 EMS 行业的市场集中度相对较高，国际上领先的 EMS 厂商均具备为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌、销售以外的服务能力。电子装联行业供应链较为复杂，涉及包括 PCB、芯片、主被动元件等在内的各种电子元器件，故供应链更容易受到上游零件短缺的冲击，因此供应链能力已成为电子装联行业的核心竞争力之一。此外，EMS 行业随着人工智能、大数据等新技术应用场景的多元化和应用深化，客户需求更加多样化、个性化，且新技术新产品迭代和更新频率加快，对于 EMS 厂商的柔性制造能力、服务响应速度、辅助设计与后端检测服务能力也提出了更高要求。

综上所述，2024 年以来，在人工智能的强劲推动以及产业下游库存回补需求的双重作用下，全球电子产业整体需求呈现出稳步增长的态势。其中，AI 算力相关的硬件需求以及汽车电动化/智能化趋势，成为行业增长的主要驱动力。

（2）主营业务分析

2024 年全球经济修复缓慢，地区分化较为明显，宏观环境更加复杂多变。IMF（International Monetary Fund，即国际货币基金组织） 2024 年 10 月发布的最新研究显示，2024 年全球 GDP 增速为 3.2%，增速较 2023 年下降 0.1 个百分点。电子产业受益于 AI 带来的算力需求拉动以及周期性的库存回补，整体需求略有修复。

在市场拓展层面，公司紧抓 AI 技术发展带动的算力与高速网络通信需求增长、汽车电动化/智能化趋势持续深化，以及通用服务器市场需求修复等机遇，加大各业务市场开发力度，推动产品结构进一步优化。在运营管理层面，公司继续推动数字化与智能制造的价值释放，加强系统化降本控费，提升竞争力。在绿色可持续发展方面，公司围绕碳排放中长期目标，持续完善产品全生命周期碳排放管理体系，积极开展系列节能减碳行动，推进绿色低碳发展。报告期内，公司实现营业总收入 179.07 亿元，同比增长 32.39%；归属于上市公司股东的净利润 18.78 亿元，同比增长 34.29%。

1）印制电路板业务充分把握算力及汽车电子市场机遇，营收及利润稳健增长

报告期内，公司印制电路板业务实现主营业务收入 104.94 亿元，同比增长 29.99%，占公司营业总收入的 58.60%；毛利率 31.62%，同比增加 5.07 个百分点。

公司在通信领域把握行业结构性机会，实现产品结构优化。2024 年通信市场不同领域需求分化较大，根据专业机构 Dell’Oro 最新研究，2024 年度全球电信设备市场同比下滑幅度或进一步扩大至 8%-10%，但在全球云服务厂商对算力相关需求的拉动下，400G 及以上的高速交换机、光模块需求显著增长。报告期内，公司通信领域主要得益于高速交换机、光模块产品需求增长，有线侧通信产品占比提升，实现了订单规模同比快速增长，产品结构进一步优化，盈利能力有所改善。

公司在数据中心领域受益于 AI 服务器相关需求增长及行业周期性回暖，业务规模明显增长。2024 年全球主要云服务厂商整体资本开支同比大幅增长，根据专业机构 Omida 数据，2024 年全球服务器资本开支约为 2,290 亿美元，同比增长约 88%。由于云服务厂商资本开支重点面向 AI 算力基础设施投入，带动了 AI 服务器及相关配套产品的需求增长，叠加通用服务器 Eagle Stream 平台迭代升级，服务器总体需求显著回温。受益于上述因素，报告期内，公司数据中心领域订单同比取得显著增长，成为 PCB 业务继通信领域后第二个达 20 亿元级订单规模的下游市场。

公司在汽车领域把握汽车电动化/智能化趋势带来的增量机会，订单需求持续释放。根据乘联会数据统计，2024 年全球汽车销量达 9,060 万台，其中新能源汽车份额达 19.7%。报告期内，公司汽车电子订单增速连续第三年超 50%，订单增量主要来自公司前期导入的新客户定点项目需求释放，以及 ADAS 相关产品需求的稳步增长。

报告期内，PCB 业务总体产能利用率较 2023 年显著改善，公司针对性开展多项运营管理能力提升工作，通过提升原材料利用率、前置引导客户设计、优化能源管理等多种方式强化成本竞争力，并针对部分瓶颈工序进行技术提效，保障高效产出。新项目建设方面，公司积极推进泰国工厂以及南通四期项目的基础工程建设，为后续业务拓展提供支撑。

2）封装基板业务聚焦能力建设与市场开发，推动新产品持续导入

报告期内，公司封装基板业务实现主营业务收入 31.71 亿元，同比增长 37.49%，占公司营业总收入的 17.71%；毛利率 18.15%，同比减少 5.72 个百分点。

2024 年全球封装基板市场需求温和修复。根据 Prismark 2024 年第四季度报告统计，2024 年全球封装基板预计销售额同比增长 0.8%。报告期内，公司封装基板业务加大市场拓展力度，加快推进基板新产品和新客户导入，推动订单较去年增长。封装基板业务毛利率同比下降，主要由于广州封装基板项目爬坡、金盐等部分原材料涨价，叠加下半年 BT 类基板市场需求波动、产能利用率有所下降等因素共同影响。

报告期内，公司封装基板业务持续聚焦能力建设并加大市场拓展力度。BT 类封装基板中，公司存储类产品成功推动客户新一代高端 DRAM 产品项目的导入及后续稳定量产，叠加存储市场需求同比改善，支撑基板业务订单同比增长；处理器芯片类产品，实现了基于 WB 工艺的大尺寸制造能力突破和 FC-CSP 类工艺技术能力提升，助力基板工厂导入更多新客户、新产品；RF 射频类产品，稳步推进新客户新产品导入，完成了主要客户的认证审核，为后续发展巩固基础。针对 FC-BGA 封装基板，已具备 16 层及以下产品批量生产能力，18、20 层产品具备样品制造能力，各阶产品相关送样认证工作有序推进。

新项目方面，无锡基板二期工厂与广州封装基板项目的能力建设、产能爬坡均稳步推进。报告期内，无锡基板二期工厂已实现单月盈亏平衡。广州封装基板项目产品线能力快速提升，产能爬坡稳步推进，已承接包括 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单，但总体尚处于产能爬坡早期阶段，重点仍聚焦能力建设，由此带来的成本及费用增加，对公司利润造成一定负向影响。

3）电子装联业务通过紧抓产业机遇，保持稳健增长

报告期内，公司电子装联业务实现主营业务收入 28.23 亿元，同比增长 33.20%，占公司营业总收入的 15.76%；毛利率 14.40%，同比减少 0.26 个百分点。

2024 年，公司电子装联业务充分把握数据中心及汽车电子领域的需求增长机会，推动营收增长。数据中心领域，公司重点把握算力需求带来的相关机会，争取了更多的优质项目，改善盈利能力；汽车电子领域，公司持续强化专业产品线竞争力建设，受益客户合作深度增加及需求放量，带动汽车相关营收稳步增长。

内部运营上，公司继续依托智能制造与数字化赋能制造过程管理，提升人员效率、减少浪费与缺陷。持续优化供应链管理水平，提升前端辅助设计及后端增值服务能力，加强对客户的一站式服务水平。

4）继续加大研发投入，高阶产品技术能力稳步提升

公司长期坚持技术领先战略，以技术发展为第一驱动力，高度重视技术与产品的研发工作，持续加大研发投入规模，不断提升研发和创新能力。报告期内，公司研发投入占营收比重为 7.10%。公司各项研发项目进展顺利，下一代通信、数据中心及汽车电子相关 PCB 技术研发，FC-BGA 基板产品能力建设， FC-CSP 精细线路基板和射频基板技术能力提升等项目均按期稳步推进。报告期内，公司参与的“CMOS 毫米波大规模集成平板相控阵技术及产业化”项目荣获国家技术发明二等奖；子公司无锡深南通过“无锡市工程技术研究中心”认定；公司新增授权专利 122 项，新申请 PCT 专利 6 项，多项产品、技术达到国内、国际领先水平。

5）深入推进数字化转型与流程变革，提升经营管理能力

2024 年公司继续深入推进流程变革与数字化转型工作，深化落实制程、运营、流程、设备、产品等维度的数字化建设，重点提升各监控指标的数据透明化与可视化，进一步提高质量管理能力，促进内部精益持续改善，减少异常、减少报废、减轻人员负荷、提升生产效率，有效降低相关成本。公司实现多个数字化项目在业务层面的落地应用，加快建设流程型组织，有效支持市场开发和订单交付效率，促进公司经营管理能力及财务成果的综合提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	25,302,247,864.46	22,606,867,760.88	11.92%	20,732,418,282.96
归属于上市公司股东的净资产	14,617,020,314.27	13,183,740,540.64	10.87%	12,251,659,553.96
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	17,907,445,251.30	13,526,425,962.45	32.39%	13,992,454,035.04
归属于上市公司股东的净利润	1,877,565,481.01	1,398,114,737.36	34.29%	1,641,239,155.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,739,872,642.10	997,953,922.58	74.34%	1,499,871,047.38
经营活动产生的现金流量净额	2,982,221,520.41	2,589,283,004.69	15.18%	3,179,833,339.56
基本每股收益（元/	3.66	2.73	34.07%	3.22

股）				
稀释每股收益（元/股）	3.66	2.73	34.07%	3.22
加权平均净资产收益率	13.58%	11.07%	2.51%	14.71%

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,961,013,853.78	4,360,002,358.70	4,728,481,534.30	4,857,947,504.52
归属于上市公司股东的净利润	379,571,805.82	607,728,400.80	500,754,864.04	389,510,410.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	335,516,529.22	568,540,859.23	472,024,247.33	363,791,006.32
经营活动产生的现金流量净额	562,835,154.99	835,933,304.52	265,250,926.72	1,318,202,134.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,863	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,393	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中航国际控股有限公司	国有法人	63.97%	328,068,670	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.11%	10,836,284	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司－易方达上证 50 指数增强型证券投资基金	其他	1.03%	5,299,888	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300	其他	0.71%	3,639,740	0	不适用	0	

交易型开放式指数证券投资基金						
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	0.54%	2,787,585	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金	其他	0.51%	2,607,170	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达信息产业混合型证券投资基金	其他	0.50%	2,567,726	0	不适用	0
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.48%	2,469,094	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.48%	2,461,924	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零五组合	其他	0.42%	2,173,070	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

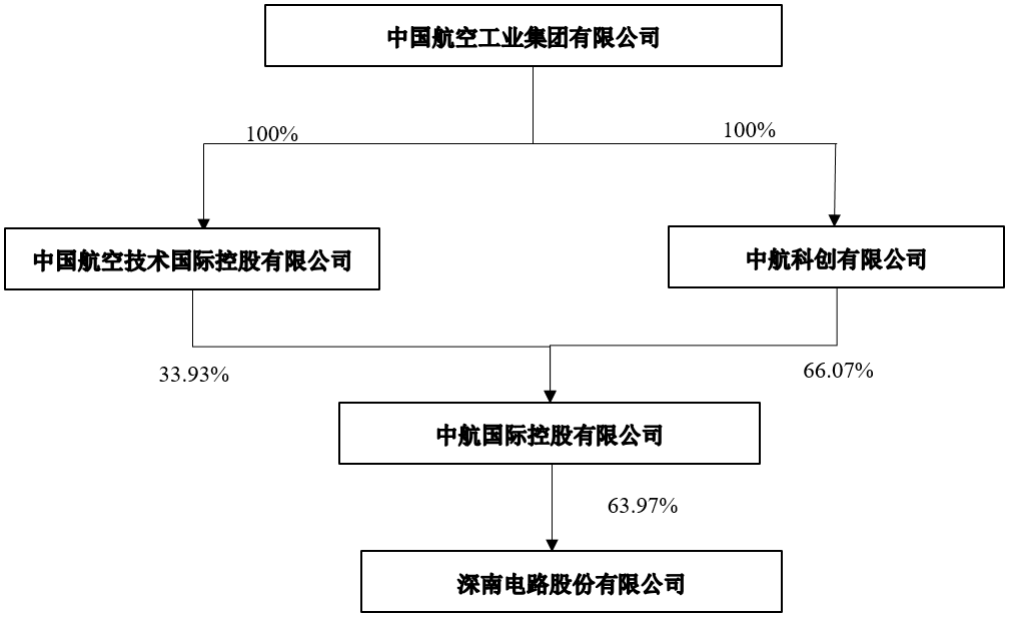
□适用 ☑不适用

（2） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

不适用。